



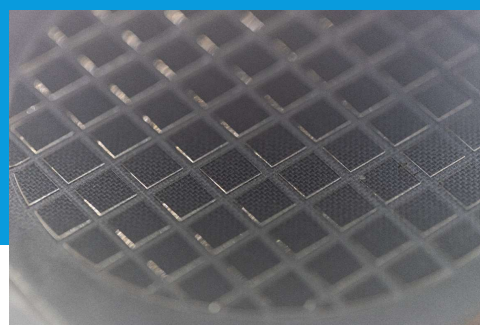
合同会社 **ブリマテック**
BRIMATEC,LLC

会社案内

試験片製作

試作

量産



ブリマテックは新技術“スクライブ & ブレーク”で
脆性基板を受託切断する会社です



会社概要



代表 留井 直子 (とめい なおこ)

設立 2021年05月06日

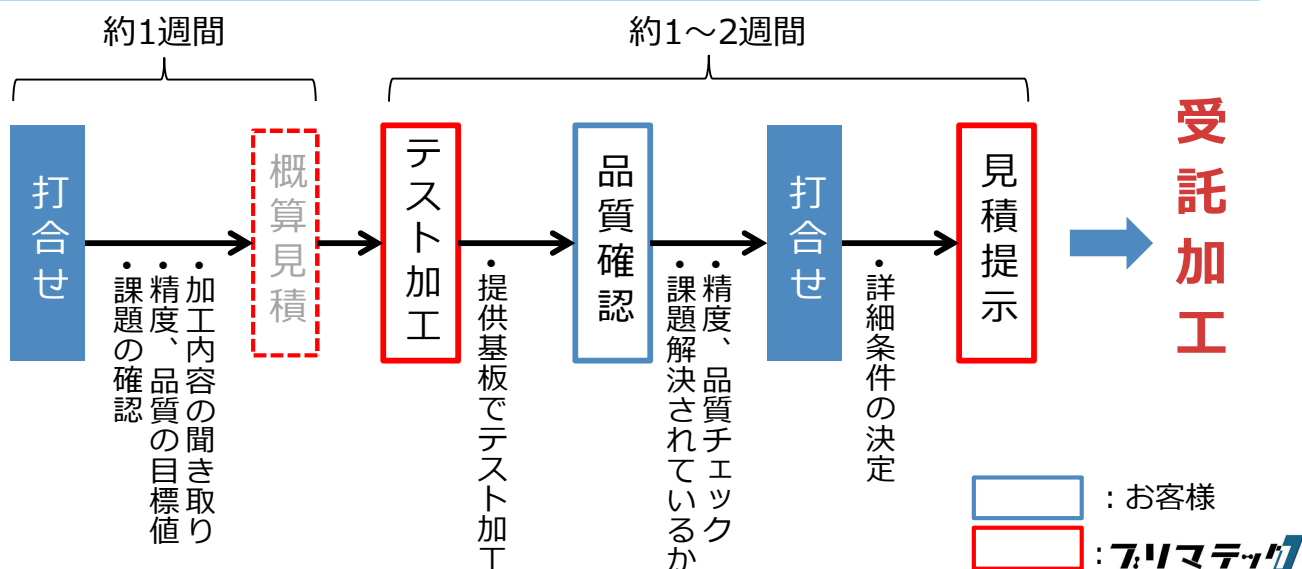
資本金 9,000,000円

事業内容 セラミックス・ガラス・半導体などの脆性材料の受託切断加工
セラミックス・ガラス・半導体などのチップ販売
切断技術のプロセスサポート

経営理念 仕事は楽しもう！
やりたい事はカタチにしよう！
“切断”技術の可能性を追求しよう！
そしてお客様が求める品質を提供しつづけよう！

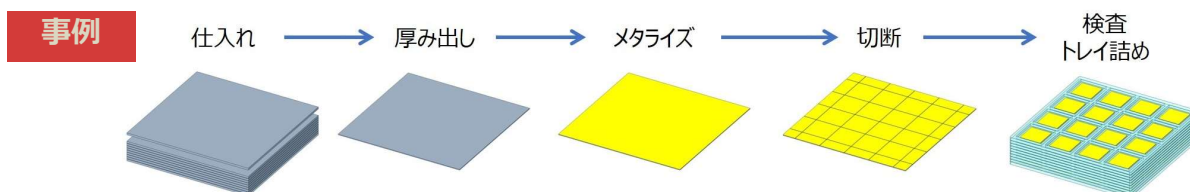


受託加工フロー



コーポレート企業

コーポレート企業様との連携により、仕入れ・加工・検査など一貫した生産が可能です。
納期とコストの削減だけでなく、お客様のニーズにマッチした方法を提案します。



チップ販売

チップを製作する切断技術と仕入れから提供までの一貫生産を生かし、
格安でのチップ販売を行っています。

材料 : Si<001>、4H-SiC、サファイア、アルミナ、窒化アルミ など
サイズ : □10mm

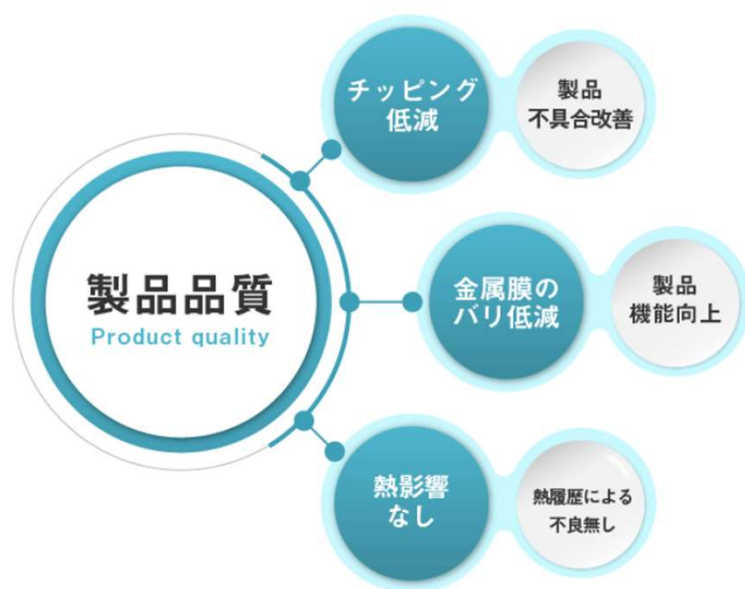
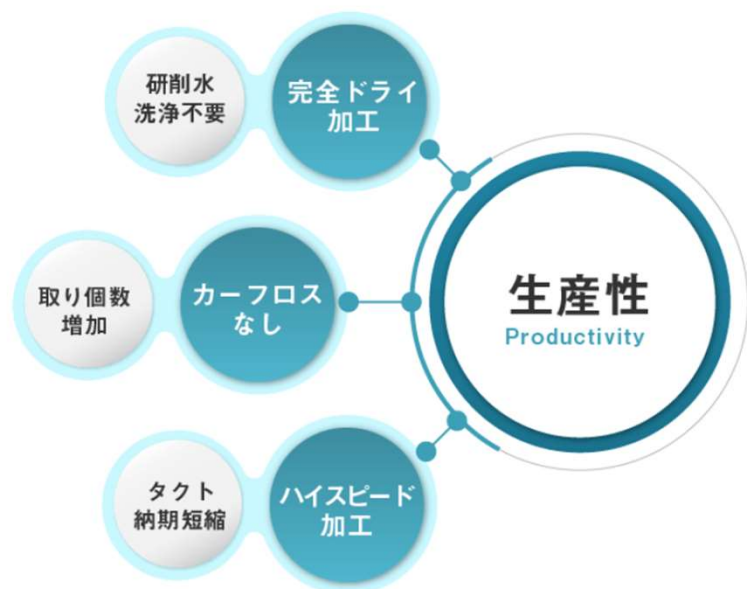
※材料・仕様は変更になる可能性があります。



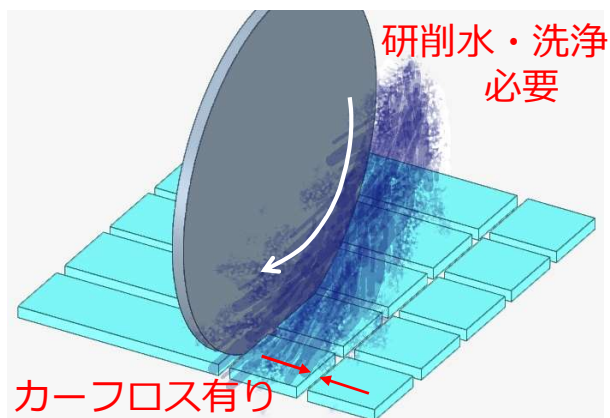
割断 ; スクライブ & ブレーク (S&B)

“割断 ; スクライブ & ブレーク (S&B)”は、ガラス・セラミックス・半導体などの材料を効率よく切断する方法です。

材料のもつ、硬くて脆いという特性を活かし、亀裂進展を利用して加工するため従来の加工技術とは異なる品質が得られます。

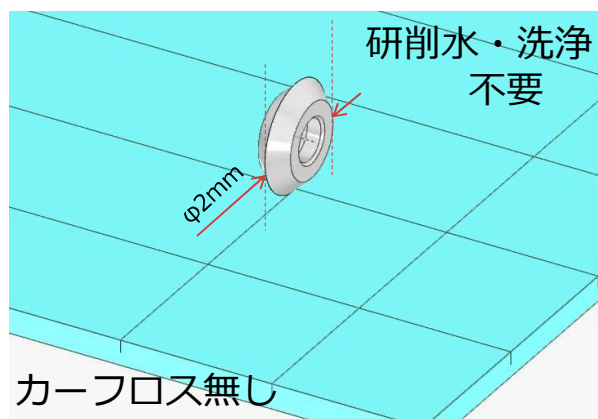


従来加工（ダイシング）イメージ



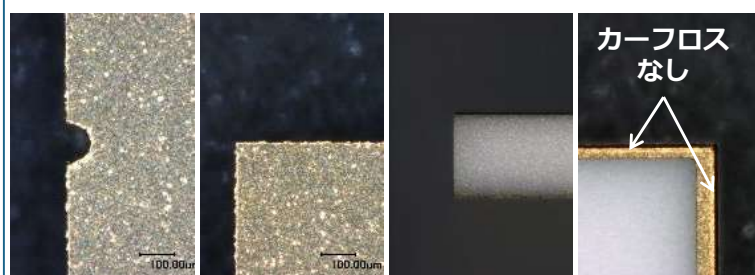
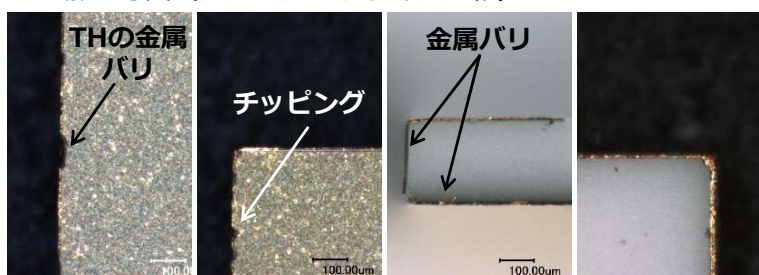
砥石（ブレード）を高速回転させることで基板材料を削り取る加工

スクライブ加工イメージ



直径2mmの工具に荷重をかけることで基板材料に亀裂を進展させる加工（削り取らない加工）

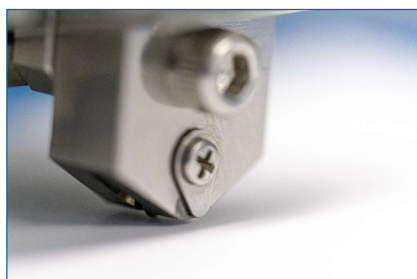
<<加工写真（アルミナ メタライズ基板）>>



S&B加工

スクライブ工程

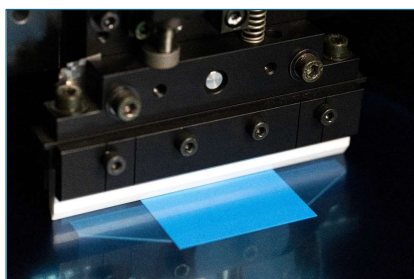
切断のきっかけとなる
スクライブラインを形成する



基板反転
+
保護フィルム貼付け

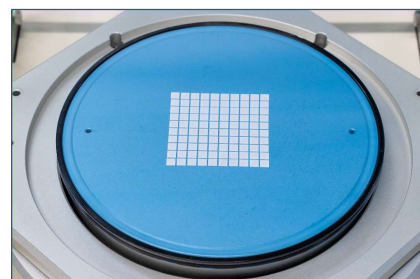
ブレイク工程

スクライブラインに沿って
亀裂進展させ個片にする

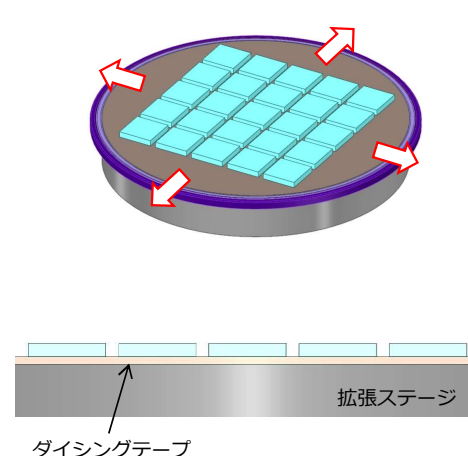
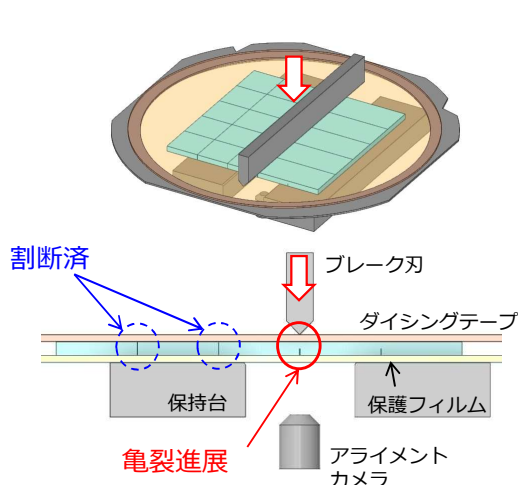
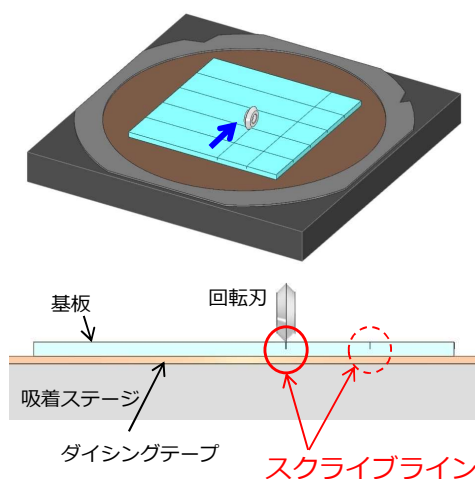


エキスパンド

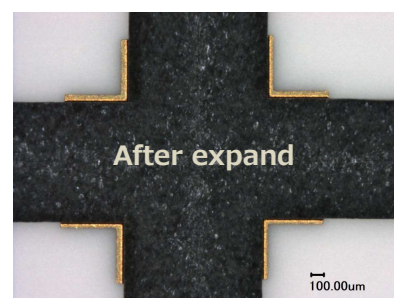
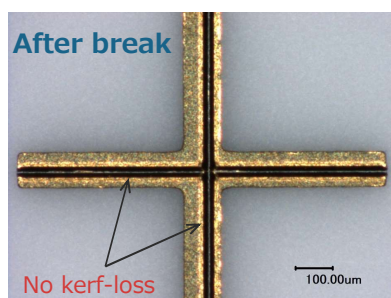
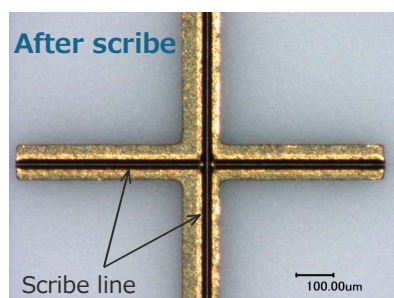
隣接する個片同士の接触防止のため
テープを拡張する



<<イメージ図>>



<<加工写真>>

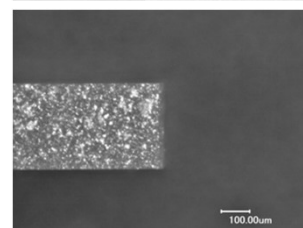
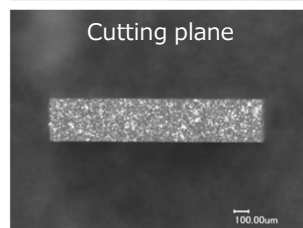
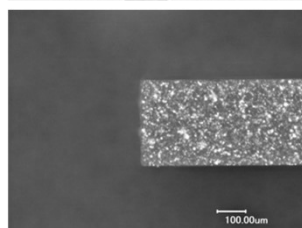
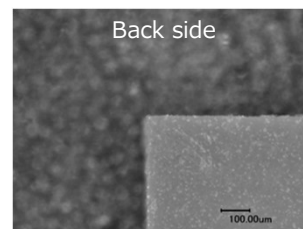
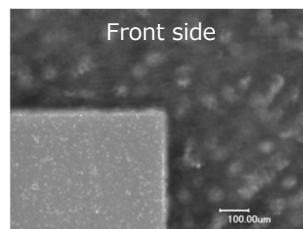
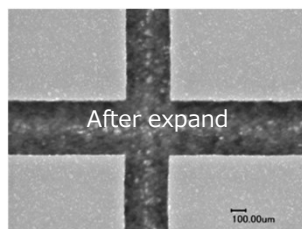
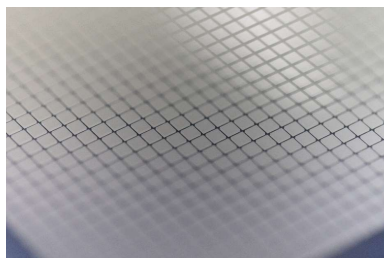


<<装置スペック>> ※対応以上のサイズ/厚さは応相談

	スクライバ	ブレイカ	エキスパンド
対応基板サイズ	～8inchウエハ、～□200mm	～4inchウエハ、～□115mm	～4inchウエハ、～□115mm
対応基板厚さ	0.1～1.5mm	0.1～1.5mm	—
加工速度	Max 300mm/s	Max 30mm/s	—
対応リングフレーム		6inchリングフレーム	6inchリングフレーム

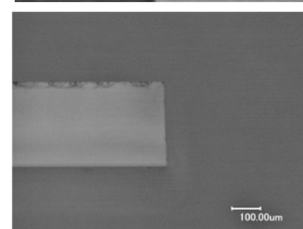
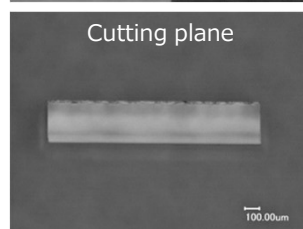
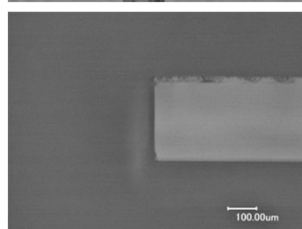
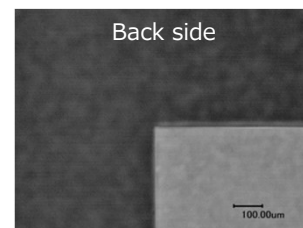
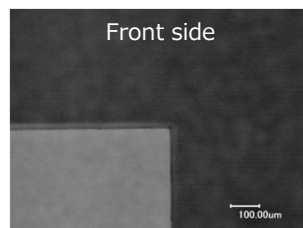
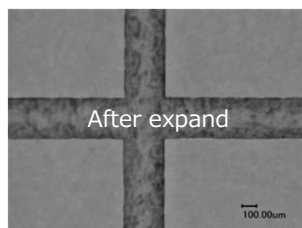
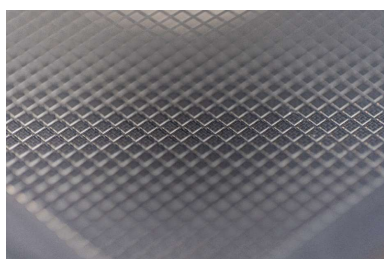
AlN

- 材料 : 窒化アルミ (AlN)
- 厚み : 0.3 mm
- 基板サイズ : □50x50 mm
- チップサイズ : □1.5x1.5 mm



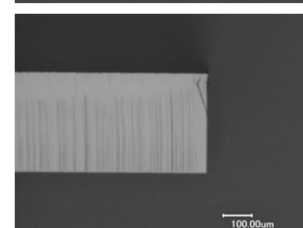
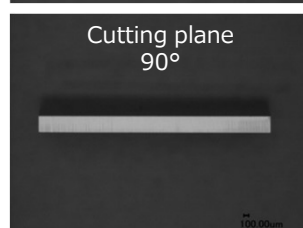
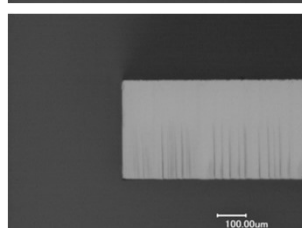
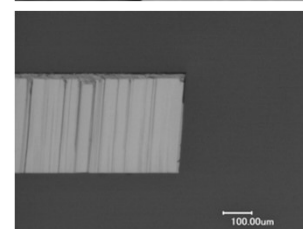
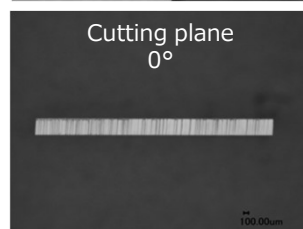
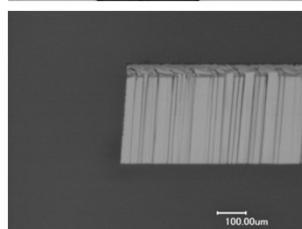
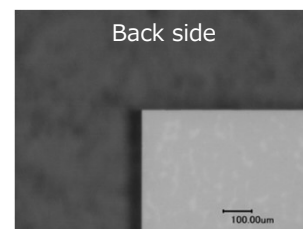
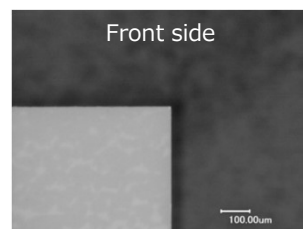
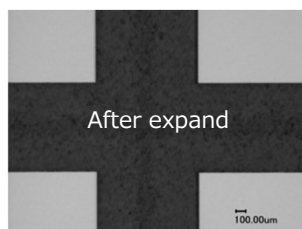
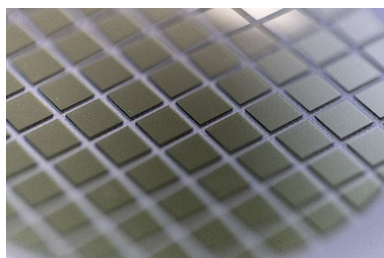
Glass

- 材料 : Glass
- 厚み : 0.3 mm
- 基板サイズ : □50x50 mm
- チップサイズ : □1.5x1.5 mm



SiC

- 材料 : 4H-SiC (4°オフ)
- 厚み : 0.35 mm
- 基板サイズ : 2 inch
- チップサイズ : □5x5 mm



アクセス

所在地 〒533-0002
大阪府大阪市東淀川区北江口4丁目3-33

TEL/FAX 06-6195-9177

Mail address info@brimatec.net

HP <https://brimatec.net>

HP



YouTube



Instagram



さまざまな材料を切断加工致します。お気軽にご相談くださいませ。